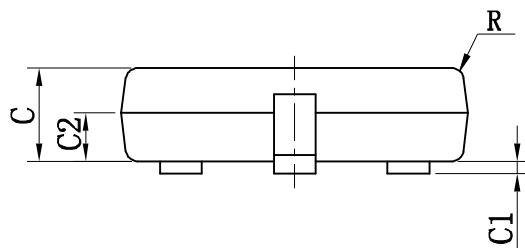
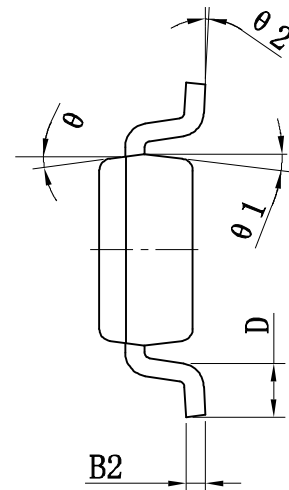
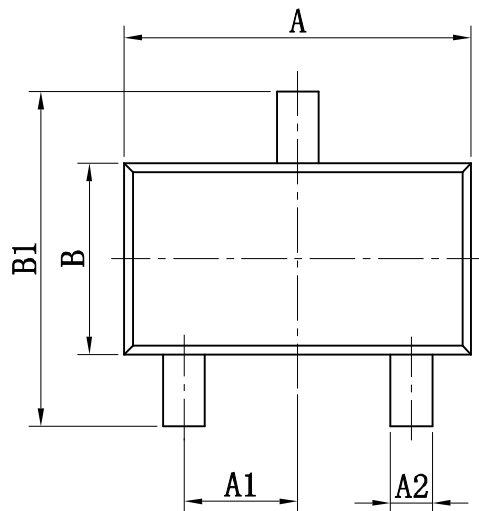




| 尺寸/<br>SYMBOL | 最小/MIN (mm) | 最大/MAX (mm) | 尺寸/<br>SYMBOL | 最小/MIN (mm) | 最大/MAX (mm) |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| A             | 2.820       | 3.020       | C1            | 0.000       | 0.100       |
| A1            | 0.950 (BSC) |             | C2            | 0.378       | 0.438       |
| A2            | 0.350       | 0.500       | D             | 0.300       | 0.600       |
| B             | 1.600       | 1.700       | $\theta$      | 9° TYP4     |             |
| B1            | 2.650       | 2.950       | $\theta 1$    | 10° TYP4    |             |
| B2            | 0.080       | 0.200       | $\theta 2$    | 0~8°        |             |
| C             | 0.700       | 0.800       |               |             |             |



|    |     |            |                   |            |                                 |     |
|----|-----|------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----|
| 制图 | 邓景勇 | 2018.04.03 | 名称                | 生效日期       |                                 |     |
| 审核 |     |            | TS0T23-3<br>封装产品图 | 等级标记       | 重量                              | 比例  |
| 批准 |     |            |                   |            |                                 | 1:1 |
| 单位 | mm  |            | 图号                | 页数         | 第1页 共1页                         |     |
| 镀涂 |     |            | C-0L-059          | 气派科技股份有限公司 |                                 |     |
|    |     |            | 版次                | D          | CHINA CHIPPACKING TECH CO., Ltd |     |